

# マウンティングフィルム & T/A・I/P (Mounting Film & T/A・I/P)



ニッタ・ハースのマウンティングフィルムおよびT/A(テンプレート・アセンブリー)、I/P(インサート・プロセス)は、シリコンウェーハや、LCD用基板ガラスなどを精密研磨する工程で被加工物(ワーク)を保持する製品です。ワークに金属汚染を引き起こすことなく純水のみで保持するとともに、均一に研磨できるように設計されており、お客様のご要望に応じた仕様での製作も可能です。

Nitta Haas mounting film, T/A (template assembly), and I/P (insertion process) are the products manufactured and sold, in order to carry out precision polishing of silicon wafer and the processed materials (objects), such as Silicon wafer and substrate glass for LCD. While holding only with pure water without causing metal contamination to objects, they are designed to polish uniformly. These products are available for customers demands.

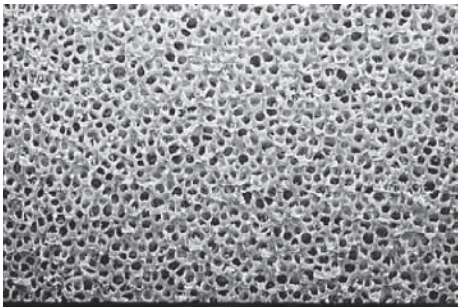
## マウンティングフィルム (Mounting Film)

### Rシリーズ (R Series)

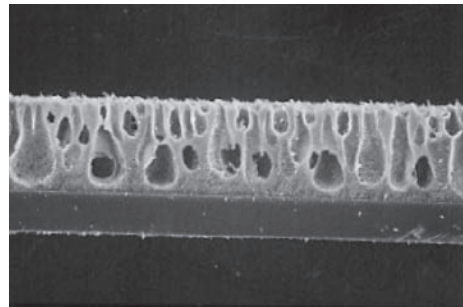
#### 特長 (Benefits)

- 高平坦性及び均一性に寄与 (Good for flatness and uniformity)
- ウェーハの着脱が容易 (Easy replacement of wafer)

#### 構造 (SEM Image, Sample/R601)



SEM: Surface Section



SEM: Cross Section

- \* R601は安定性の高い原材料を採用し、品質安定性に優れたタイプです
- \* Features new formulation designed for high stability.

#### 物性 (Physical Properties)

Type	圧縮率 (Compressibility) (%)	厚み (Thickness) (μm)
R601	28.0	600
R303	8.5	580
R305	4.5	580

- \* 感圧接着テープを除く本体の厚さを表示しています。
- \* Shown is a thickness of film itself, excluding pressure sensitive adhesive tape.

# ブランク材付きワックスレス研磨プロセス (Waxless Polishing Process With Blank Component)

## T/A・I/P

T/A・I/PはシリコンウェーハやLCD用ガラス基板(ワーク)をワックスレスで研磨機のキャリアプレートに保持するための製品です。ウェーハや基板の平坦性向上、自動化による生産性の向上が見込まれます。また、ワークを取り外した後の溶剤による洗浄が不要ですので、工程の短縮や経費節減、環境破壊の防止にも効果が得られます。さらに、パッド、スラリーとの組み合わせにより、相乗効果が期待でき、優れた研磨システムを確立することができます。サイズ、材質を各種取り揃え、お客様のご要望に応じた製品をお届けいたします。

T/A and I/P are products to affix semiconductor silicon wafers and glass substrates to the carrier plate of a polishing machine without using mounting wax. Our T/A and I/P offer excellent flatness and improve productivity through their automated operations. They also feature solvent-free wafer cleaning, which contributes to shorter processing time, lower expenses and prevents environmental damages. A synergetic effect is expected by combining polishing pads and slurries with T/A and I/P, which leads to the establishment of an optimum polishing system. We provide a wide variety of sizes and component materials to meet the specific demands of our customers.

### <T/A>

T/Aはマウンティングフィルムとブランク材が一体となった形で構成されています。この為、交換やメンテナンスが容易です。T/A consists of a mounting film component and a rigid blank component. Maintenance is simple with easy replacements.

### <I/P>

I/Pは分離式のマウンティングフィルムとブランク材が各々分離された形で構成されています。ブランク材をキャリアプレートに残したまま、インサートするマウンティングフィルムを容易に短時間で交換することが可能です。ブランク材が消耗して使えなくなるまでは、マウンティングフィルムを随時交換して長期間使用できるため効率が良く経済的です。

I/P fixturing assembly, consists of a detachable poromeric mounting film component and a rigid blank component. You can easily replace the mounting component for insertion in a short time. Because you can replace mounting film until the blank component is completely worn out, it lasts longer and yields higher efficiency and cost-effective.

T/AおよびI/Pは、研磨条件に最適なマウンティングフィルムを選択することにより、最高水準のウェーハ平坦性が得られます。The selection of an optimized mounting film for the polishing conditions enables you to obtain the highest level of wafer planarity.

## 製品ラインアップ (Products Lineup)

構成材 (Components)	T/A	I/P
バックアップフィルム (Backing film)	Rシリーズ (R Series)	
ブランク材 (Blank component)	ガラスエポキシシート (Glass epoxy sheet)	ガラスエポキシシート (Glass epoxy sheet)
	テトロンエポキシシート (Tetronic epoxy sheet)	ポリカーボネートシート (Polycarbonate sheet)
	フェノール樹脂シート (Phenol resin sheet)	ポリエステルシート (Polyester sheet)



※本カタログに記載されている会社名・製品名等は各社の商標または登録商標です。また、記載されている物性等の数値は代表値を示しており、製品の規格を保障するものではありません。

